

## ウェハレベル接合を用いたミリメートル波のアンテナ

by Y. Yoshida et al.

図2の(b)に示す従来構造を、(a)に示す構造にすることにより、ウェハ間のギャップを精度よくスタックできる。ウェハレベル接合は、BTレジンにより行われている。

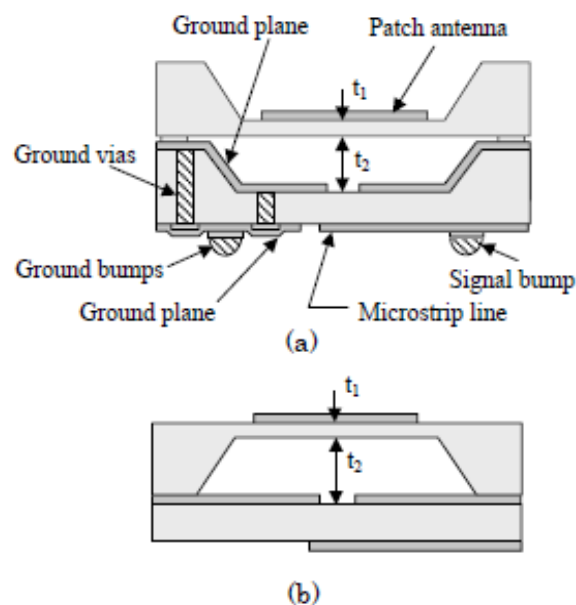


Fig. 2 Cross sectional views of (a) the design of Fig. 1 and (b) the previous work [3].

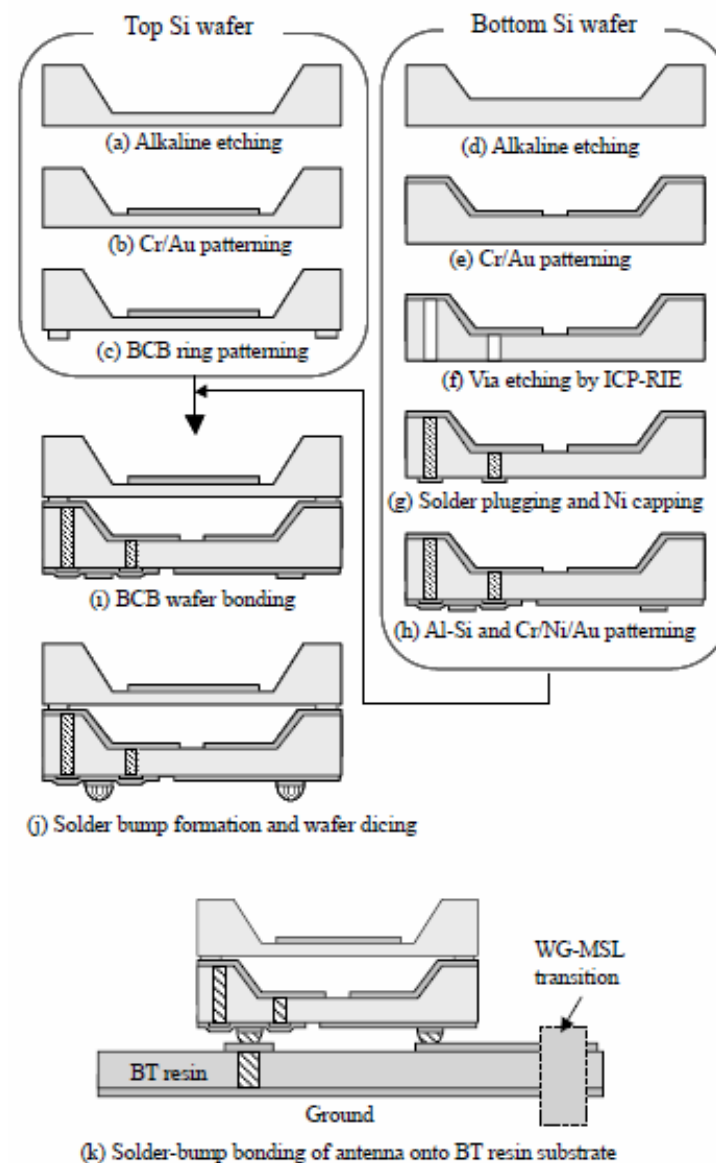


Fig. 4 Antenna wafer process flow (steps a to j) and solder bump bonding of antenna onto resin substrate (step k).